

Pb75In25 焊料

特点

- 良好的延展性、可锻性，延展性和可锻性在超低温下仍可以保持，其合金在恶劣的环境中也能保持良好密封性能。
- 低温焊料，熔点 240/260°C，铟的导热率较高（在 85°C 时为 86W / mK），因此被广泛应用在热管理应用中，散发电子元件产生的热量
- 铜合金焊料在跌落试验中的耐抗程度优于其他低熔点合金
- 无蚀金现象，适合镀金界面
- 适合多次焊接或者需要较低回流温度的焊接。

描述

- Pb75In25 属于铟铅合金系列焊料，熔点 240/260°C。铟铅合金系列焊料不同组分具有一定温差，适合分步焊接，可以提供熔点 174~310°C 的解决方案。In、Pb 均是能降低表面能的元素，Pb75In25 焊料能与对铜、金等界面润湿，具有很好的兼容性。铟铅焊料还具有良好的抗热疲劳性，对金层具有良好的浸润性，不会出现锡基钎料的蚀金蚀银现象，非常适合镀金界面。另外，延展性和可锻性在超低温下仍可以保持，其合金在恶劣的环境中也能保持良好密封性能。铟的导热率较高（在 85°C 时为 86W / mK），因此被广泛应用在热管理应用中，散发电子元件产生的热量

焊料成分及性能

焊料成分:

元素	Wt%
铟 (In)	25.0±0.5
铅 (Pb)	余量

物理性能:

产品名称	熔点/°C 固相/液相	密度 g/cm ³	电阻率 μΩ·m	热导率 W/m·K	热膨胀系数 10 ⁻⁶ /°C	抗拉强度 Mpa
Pb75In25	240/260	9.97	0.375	18	26	37.58

操作细节

- 可使用防静电、防损伤的治具拾取焊料，防止焊料污染和损伤
- 助焊剂兼容性：Pb75In25 焊料和目前市场上的主要免清洗和水溶性的电子级别助焊剂相容。

安全

- 请工作人员在有足够通风和必要的个人防护条件下使用该产品。
- 请不要与其它有毒化学品混合。

加工尺寸

厚度(t)	长宽或直径(L/W/D)典型公差	
t<0.40mm	±0.02mm	
0.40mm≤ t <1.00mm	±0.03mm	
t ≥1.00mm	±0.05mm	
厚度(t)	厚度典型公差	
	常规焊料合金	钢合金
t<0.05mm	±0.005mm	±0.01mm
0.05mm≤ t <0.10mm	±0.008mm	±0.01mm
0.10mm≤ t <0.20mm	±0.01mm	
0.20mm≤ t <0.40mm	±0.02mm	
0.40mm≤ t <1.00mm	±0.03mm	
t ≥1.00mm	±5%	

储存及产品管理

- 储存: 该产品的最佳保存温度为 25±5°C, 相对湿度≤55%RH。
- 产品不使用时须保持容器密封, 并放置于电子防潮箱保存, 条件允许情况下建议放置于洁净氮气柜保存。

包装方式

- 预成型焊片的包装方式多样性, 可采用散料式包装、卷带式包装及载带式包装, 也可按客户要求要求进行包装。

保质期

- 预成型焊片的保质期取决于其合金成分和存储环境, 该合金保质期原则上: 6个月 (从生产日期算起)。